

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2016年3月10日(10.03.2016)



(10) 国際公開番号
WO 2016/035687 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/301 (2006.01) *C09J 7/02* (2006.01)
B23K 26/38 (2014.01) *C09J 201/00* (2006.01)
B23K 26/53 (2014.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2015/074338
- (22) 国際出願日: 2015年8月28日(28.08.2015)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2014-181752 2014年9月5日(05.09.2014) JP
- (71) 出願人: 古河電気工業株式会社(FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1008322 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 中村 俊光(NAKAMURA, Toshimitsu); 〒1008322 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号 古河電気工業株式会社内 Tokyo (JP). 杉山 二郎(SUGIYAMA, Jirou); 〒1008322 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号 古河電気工業株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 松下 亮, 外(MATSUSHITA, Makoto et al.); 〒2220033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-5-19 アプリ新横浜ビル5階 Kanagawa (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

(54) Title: SEMICONDUCTOR PROCESSING TAPE AND SEMICONDUCTOR DEVICE MANUFACTURED USING SAME

(54) 発明の名称: 半導体加工用テープ及びこれを使用して製造した半導体装置

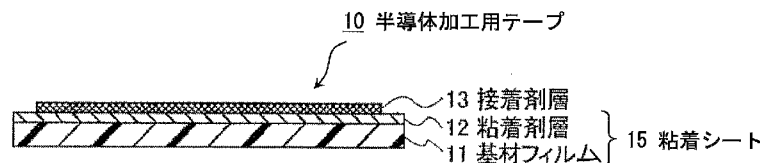


FIG. 1:
10 Semiconductor processing tape
11 Base material film
12 Adhesive layer
13 Attachment agent layer
15 Adhesive sheet

(57) Abstract: Provided is a semiconductor processing tape having excellent workability, in that it is not cut and does not break due to shocks during transportation or the like, and does not break even when stretched in a pre-cutting step in which an attachment agent layer is processed to achieve a specified size. This semiconductor processing tape (10) is characterized by being formed by laminating an attachment agent layer (13) and an adhesive sheet (15), with a tearing strength (A) of 0.8 MPa or greater for the attachment agent layer (13) in a right-angled tear testing method as defined in JIS K7128-3, and a tearing strength (C) of 0.8 MPa or less at -15°C in the right-angled tear testing method as defined in JIS K7128-3.

(57) 要約: 運搬時などの衝撃で切り込みや割れが生じることなく、接着剤層を規定の大きさに加工するプリカット工程において、引き伸ばしても割れたりしない加工性に優れる半導体加工用テープを提供する。本発明の半導体加工用テープ10は、接着剤層13と粘着シート15とが積層されており、前記接着剤層13は、JIS K7128-3に規定される直角形試験法における引裂強さ(A)が0.8MPa以上であり、-15°CにおけるJIS K7128-3に規定される直角形試験法における引裂強さ(C)が0.8MPa以下であることを特徴とする。

WO 2016/035687 A1